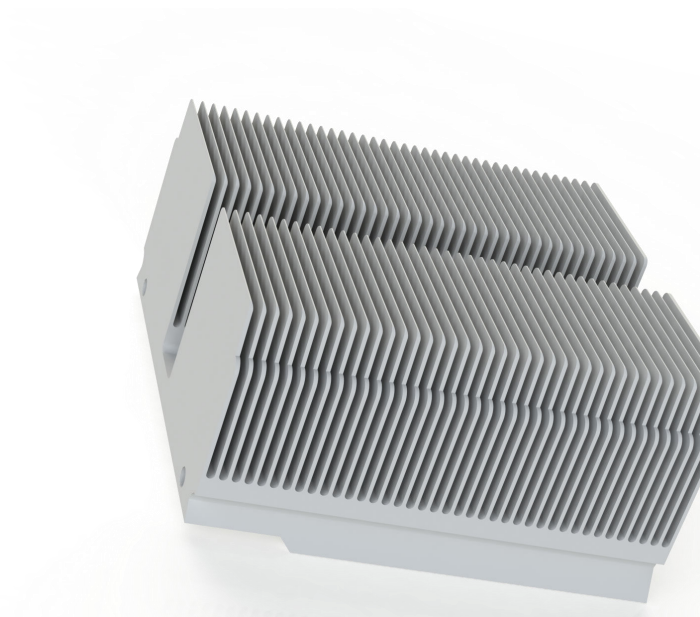

Kølegitter

Martin Knudsen

En undersøgelse af strømning, type og køleeffekt.



Indholdsfortegnelse

0.1	Indledning	1
0.2	Beskrivelse	2
0.3	Processor	3
0.4	Metode	4
0.5	Gitter	6
0.6	Beregninger	6
	0.6.1 Tvungen indvendig strømning	7
	0.6.2 Fri Konvektion	8
0.7	Konklusion	9
0.8	litteratur	10
0.9	Beregninger	10

0.1 Indledning

Computere med dertilhørende køling og termodynamiske systemer fylder generelt meget i hverdagen for de fleste mennesker, men vi ved meget lidt om de termodynamiske processer i en PC.

Forfatterne interesserer sig for moderne højtydende PC-systemer, hvor køling i særdeleshed er en meget væsentlig faktor, herunder køling af den centrale regneenhed/processor (CPU - Central Processing Unit) samt evt. dedikerede grafik regneenhed/processorer (GPU - Graphics Processing Unit).

Det termodynamiske system vi har valgt at skrive om til dette projekt i termodynamik er processor-kølere som bruger tør atmosfærisk luft som kølemedie. Hvorfor det undersøges hvor meget hurtigere luft skal flyttes, for at give køling ved tvungen indvendig strømning en bedre køle evne end konvektion.

Vi har vi valgt at definere at systemgrænsen ligger mellem processoren og det køletekniske system, således at processoren og dens interface med det køletekniske system ligger udenfor det termodynamiske system vi beskriver. Således foregår der en strøm af energi ind over systemgrænsen og ud i den anden ende af system grænsen

Processoren kommer da til at definere energistrømmen ind i systemet og dermed den varme der skal transporteres ud af systemet for at det forbliver stationært ved maksimal belastning.

Lauritzens og Eriksen, Termodynamik danner grundlaget for beregninger samt samt tabelopslag for diverse værdier i dette projekt.

0.2 Beskrivelse

Moderne CPU og GPU enheder er bygget op af millionvis af elektroniske transistorer. Disse transistorer er konstrueret af halvledermaterialer, som typisk kun bevarer deres halvlederegenskaber indenfor et bestemt temperaturområde. Bliver disse udsat for konstante drifttemperaturer udenfor dette område, degraderer ikke bare deres elektriske signaler (i form af regnefejl og signalfejl og nedsat stabilitet) men også selve halvleder materialet de er konstrueret af, med betydelig nedsættelse af levetiden til følge.

Forfatterne noterer sig at specielt GPU enhederne i en moderne PC fylder mere og mere i trit med at udviklingen af software og skærme betyder at der skal foretages flere og flere beregninger. Det betyder at der rent fysisk skal bruges flere transistorer og typisk mere energi i en GPU for at opnå det ønskede ydelsesniveau.

Det betyder reelt at termodynamik i allerhøjeste grad indgår i design, funktion og brug af en computer.

Det umiddelbare indtryk er dog at GPU og CPU i termodynamisk forstand er identiske, hvorfor ordet CPU vil brugt i flæng om både CPU og GPU.

0.3 Processor

Den elektriske effekt P afsat i en CPU kan beskrives således :

$P = \text{strømforbrug (I)} * \text{taktfrekvens (f)} * \text{kapacitans (C)} .$

I kølesystemet for en computerprocessor foregår den første varmetransmission som varmeledning fra processorens varmespreder til kølesystemet.

Ofte faciliteres denne varmetransmissionen af en kølepasta, som er med til at maksimere kontaktfladen til kølesystemet og som modvirker galvanisk tæring.

I kildelisten er inkluderet to eksempler på kølepasta, med konduktivitets værdier på hhv. 0,8 og 12,5 W/m*K.

Intentionen med kølepasta er at optimere kontakten mellem kølegitter og processor og undgå at der opstår små luftlommer, hvor der kan dannes ekstra varmemodstand. Dog vil laget af kølepasta her blive betragtet som liggende udenfor systemgrænsen.

De fleste kølegittere er lavet af aluminum, som har en varmekonduktivitet er på 229 W/m*K.

Vi antager et en dimensionel udbredelse af varme, stationært system med konstant varmestrøm. Vi antager ydermere konstant densitet og temperatur på den omgivende, tørre atmosfæriske luft.

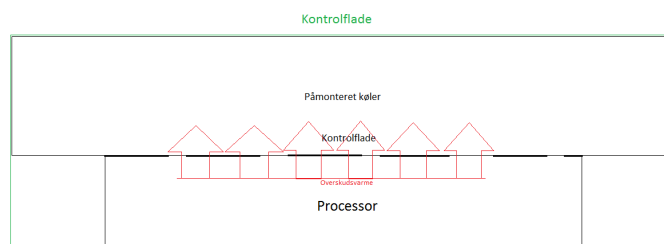
Tykkelserne på godset i den retning varmen udbrederes i er 0.5 mm for kølegitteret og regnes som en massiv væg, idet processoren regnes for at have en ens temperatur i hele sit areal. Varmen forsimples til at udbrederes i en retning og i et stationært system. Med disse antagelser kan varmemestrømmen igennem lamellerne beregnes. Luften antages at flytte sig 0.01 m/s(c, hastighed)

0.4 Metode

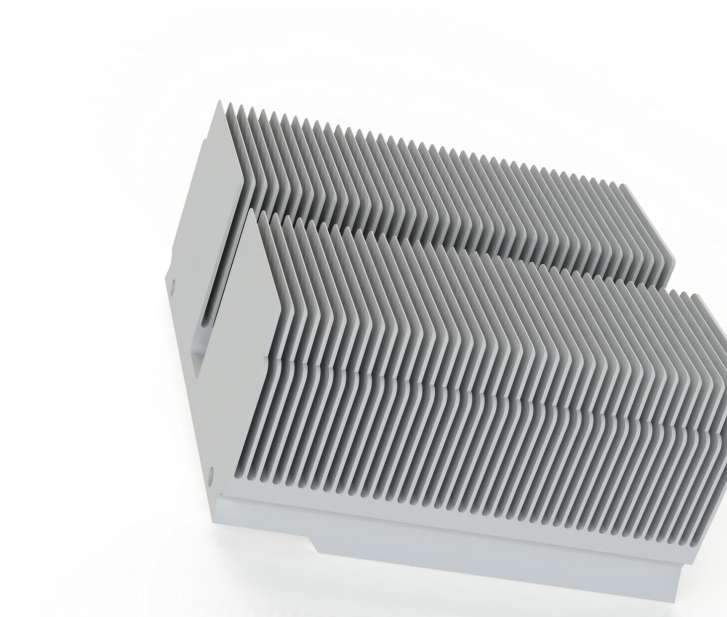
Der søges at udregne varmestrømmene for de forskellige komponenter, således at disse kan indgå i sammenligning af varme og temperatur.

1. Klarlægning af flowgeometrien
2. Beregn Referencetemperatur
3. Bestem kendetal (Re , Gr , Ra , Pr)
4. Vælg modelligning
5. Beregn varmeovergangstallet ud fra Nusselts tal

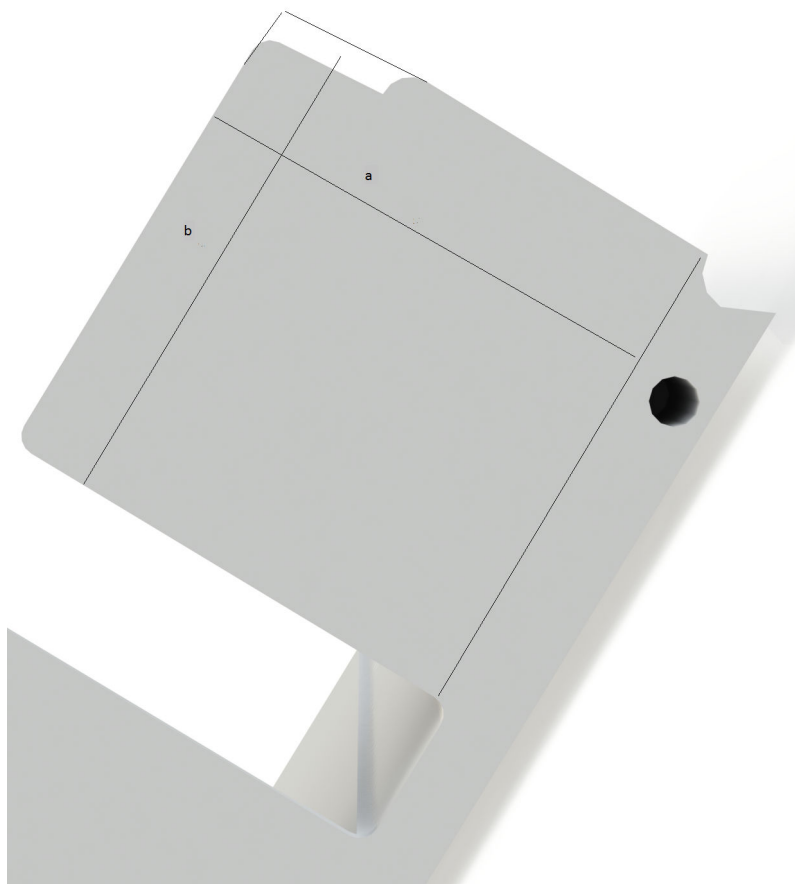
Det antages at processoren afgiver 100 % af sin varme i kølesystemet. Systemgrænserne udgøres (som tidligere nævnt) af interfacet til processoren og af bortledning af varme fra den sidste komponent i kølesystemet.



Figur 0.1. kontrollflader for systemet der regnes på.



Figur 0.2. Eksempel på kølegitter, fra grabcad.com - bruger: Fernando



Figur 0.3. Lamel. Genstand for vore termdynamiske undersøgelser. fra grabcad.com - bruger: Fernando

0.5 Gitter

Fælles for alle 3 systemer er kølegitteret af aluminium, der er i kontakt med processoren. I simple systemer udgør kølegitteret den eneste part i kølesystemet som vi har defineret det og kan selvfølgelig bestå af andre materialer end aluminium. I nærværende rapport vil der dog tages udgangspunkt i aluminium.

Kølegitteret udnytter sit store overfladeareal til at bortlede varme ved konvektion fra et fast materiale (aluminium) til et fluid (tør atmosfærisk luft). Således vil der være to termiske modstande, nemlig en varmeledningsmodstand i kølegitteret og en varmeovergangsmodstand fra fast stof til fluid.

En hyppig forekommende geometrisk struktur i et kølegitter er ribber eller lameller, der giver en naturlig strømning af den varme luft bort fra kølegitteret, hvor kun termodynamiske kræfter har indflydelse på strømningen. Denne strømning foregår mellem to ribbe/lamel-vægge.

Der præsenteres her en oversigt over de værdier der bruges i udregningerne:

Der beregnes varmestrøm for konvektion og for stråling.

Dimensionerne for kølegitteret er importeret fra en partfil i Solidworks.

$H = 20 \text{ mm}$, $b = 25,5 \text{ mm}$, $d = 1 \text{ mm}$, Areal $A_t = 93733.73 \text{ mm}^2$, $A_{lamel} = 500 \text{ mm}^2$

Massen $m = 31,58 \text{ g}$

Varmekonduktiviten for aluminium, $\lambda_{al} = 229 \text{ W/m} \cdot \text{K}$

Lameltykkelsen $\delta = 0.5 \text{ mm}$.

Den specifikke varmekapacitet $c_p = 1.008 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$

Strømningshastighed lodret, i lamellens længde på $c = 0.001 \text{ m/s}$

Hvoraf varmekonduktiviteten α er fundet ved tabel opslag $\alpha = 21.8$

Kinematisk viskositet er: 18.88 og dynamisk viskositet = 16.92

Volumenudvidelseskoefficienten $\beta_{luft} = 3,2$

Varmeledningsmodstanden : $R_l = \frac{\delta}{\lambda_{al} \cdot A_{lamel}} = 4.281$

Varmeovergangsmodstanden : $R_o = \frac{1}{\alpha_{tl} \cdot A_{lamel}} = 89.394$

Total termisk modstand er $R_{tot} = R_l + R_o = 92.225$

0.6 Beregninger

For at udregne varmestrømmen ϕ bruges udtrykket

$$\Phi = \alpha \cdot A \cdot (t_{fl} - t_v)$$

også kendt som Newtons ligning.

Varmestrømmen ϕ udregnes ved ligningen $Nu = \frac{\alpha}{\lambda}$

Nu er Nusselts tal og findes herunder ved at udregne Reynolds(Re) og Prandtls(Pr) tal.

Strømningsforholdende for luft(fluiden) imellem lamellerne i gitteret er fri indvendig strømning, idet lamellerne kan ses som kanalvægge og udgangen i en antaget lodret given retning er smal og bred med 3 åbne sider og derved tillader en fri udvikling af strømmingen. Den hydrauliske diameter bruges og sættes lig med afstanden imellem 2 givne lameller. $\approx 0.5mm$

Reference temperaturen udregnes til :

$$t_{film} = \frac{t_{lamel} + t_{fluid}}{2} \Rightarrow t_{film} = 30$$

$$\text{Grasshofs tal } Gr = \frac{g * L^3 * \beta * \Delta t}{\nu^2} = 8,771 * 10^4$$

$$\text{Prandtls tal } Pl(\text{opslag}) \Rightarrow Pr = 0.69$$

Der antages lodret laminar strømning af luften og Reynold tal undersøges for at få en idé om strømningsformen

$$Re = \frac{c_{luft} * L_{hyd}}{\nu} = 2.648 * 10^{-5}$$

Den kritiske værdi for Re hvor strømmingen overgår fra at være laminar til at blive turbulent er 10^9 . Da ovenstående beregnede værdi af Re er meget mindre end den kritiske værdi, ses at der må være tale om laminar strømning over hele længden af en lamel, hvorfor strømmingen ikke undersøges yderligere.

Hastighedsprofilen hvorved den opvarmede luft stiger til vejrs er udregnet til:
 $0.05 * Re * L_{hd} = 0.001$

Her følger et overblik over forskellene på to strømningsformer.

0.6.1 Tvungen indvendig strømning

Det medfører at Nusselts tal kan udregnes som

$$Nu = 3,66 + \frac{0.0668 * Re * Pr * \frac{D}{L_{lamel}}}{1 + 0.004 * \left(\frac{D}{L_{lamel}} * k * Re * Pr \right)^{1/4}})^{2/3} = 3.661$$

$$\text{og } \Phi_{tis} = \alpha * A(t_{fl} - t_v) \Rightarrow 2.597 * 10^6 W$$

$$\text{justeret til milimeter ved udtrykket: } \frac{\Phi = \alpha * A * (t_{fl} - t_v)}{10^6} \Rightarrow 160,4 W$$

Hvor luftens hastigheds profil er fuldt udviklet efter : $0,05 * Re = 0,03mm$

samtlig lameller afgiver da $0,75w * 40 \approx 30W$ i varmemstrøm til luften der passerer.

0.6.2 Fri Konvektion

Fri konvektion er et lidt tænkt scenarie er lidt begrænset i sin relevans, men dog brugbar for enkelt lameller og dele af kølegitteret. $Nu_{fri} = (\frac{Gr_L}{4})^4 * (\frac{0,75*Pr^{1/2}}{(0.609+1,221*Pr^{1/2}+1,238*Pr)})^{1/4}$ og ledetallet $\alpha_{fri} = 2,768 * 10^3$

Varmestrømmen $\phi_{fri} = 169,37$

0.7 Konklusion

Et varmegitter af aluminium forekommer umiddelbart at være en relativt effektiv måde at aflede varmen på. Den store hindring i varmetransmissionen forekommer at være overgangsmodstanden for luft. Materialet lader ikke til at gøre en synderlig forskel, dog skal det bemærkes at aluminium er et af de mest varmeledende materialer, billigt, let og nemt at forarbejde.

Ulempen ved sådan en konstruktion her er, at fluidets filmlag er relativt tykt og har laminart flow, hvorfor luftudskiftningen er lidt langsom og mindre effektiv i konvektion. Men materialet er generelt underordnet ift. laminart/turbulent flow og det samlede overfladeareal, hvorfor det giver god mening at aluminium bruges i vid udstrækning til pc kølesystemer.

Hvis angelsen om at opdrifthastigheden på luft er $0,5mm$ Skal luften flyttes ca. 8 gange hurtigere ved at bruge en blæser, inden filmlaget bliver brudt tilstrækkeligt til at øge varmestrømmen ϕ .

0.8 litteratur

Lauritzen og Eriksen - Termodynamik - Praktisk anvendelse (kilde: <ftp://download.intel.com/design/net>)

Petersen - elektroteknik 1 -Elektricitet og Magnetisme

0.9 Beregninger

Her følger beregninger i skitseform: